



All-in-one

## SONY SERIE L

Détails de la notation :

<b>B+</b>	NOTE RSE	>
<b>E-</b>	NOTE CYCLE DE VIE	>
<b>C-</b>	NOTE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE	>

Code EAN :

[VOIR LA FICHE CONSTRUCTEUR >](#)

[DÉCOUVRIR NOTRE MÉTHODOLOGIE >](#)

Gamme de prix

# 800 – 1000 €

Le All-in-One Serie L de SONY est équipé du processeur Intel Core i5, de la carte graphique GPU NVIDIA et possède une mémoire vive de 8 Go.

Il est labellisé EPEAT et Energy Star .



EPEAT



ENERGY STAR

## MATURITÉ RSE



**B+**

SONY présente une stratégie RSE solide et détaillée. Les enjeux majeurs au regard de l'environnement et de l'impact social sont pris en compte et des solutions mises en place. Les objectifs fixés par SONY quant à l'environnement sont ambitieux et le progrès de l'entreprise à cet égard est publié annuellement. Les fournisseurs sont inclus dans la politique sociale de SONY, qui poursuit son projet de traçabilité des composants et d'éviction des matériaux dangereux et dits "de conflits". SONY met un point d'honneur à communiquer sur la composition de son comité d'entreprise et prône son indépendance, ce qui n'est pas courant pour les entreprises japonaises. Néanmoins, les informations et les notions d'indépendances de l'entreprises ne se basent pas sur les critères européens, ce qui les rend caduques.

## CYCLE DE VIE



**E-**

**3 ans**

De garantie

**0 an**

De disponibilité des pièces

## LES PLUS

- Possibilité d'extension ou d'échange de la mémoire
- Possibilité d'extension ou d'échange de la capacité de stockage
- Possède des parties et étiquettes facilement séparables
- Ne possède pas de revêtement de surface pour les parties plastiques du boîtier/capot
- Ne possède pas de pièces plastiques monomatériaux ou facilement séparables

## LES MOINS

- Contient 0% de plastique recyclé
- Contient 0% de bioplastique
- Contient 0% de plastique recyclé dans son emballage
- Ne possède pas un emballage monomatériau
- Ne communique aucune information sur le respect de REACH

## EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES

---

Masse de la RAM (Go)	<b>8</b>
----------------------	----------

---

Masse de la Mémoire Flash (Go)	<b>Non-communicé</b>
--------------------------------	----------------------

---

Masse de la carte mère	<b>Non-communicé</b>
------------------------	----------------------

---

Part de plastiques recyclés dans le produit (%)	<b>0</b>
---	----------

---

Part de bioplastiques dans le produit (%)	<b>0</b>
---	----------

---

Masse du microprocesseur + masse de la carte graphique ou la surface de silicium dans le microprocesseur la carte graphique	<b>Non-communicé</b>
---	----------------------

---

Poids (kg)	<b>10.7</b>
------------	-------------

---

## FABRICATION

Utilisation de CFCs, HCFCs, 1.1.1 trichloro-ethane ou carbon-tetrachloride pour la production du produit final ou des modules le composant au sein du produit	<b>Non-communicé</b>
---	----------------------

---

## DISTRIBUTION

Part de carton recyclé dans l'emballage (%)	<b>90</b>
---	-----------

---

Part de plastique recyclé dans l'emballage (%)	<b>0</b>
--	----------

---

Monomatère dans l'emballage	<b>Non</b>
Emballage sans PVC	<b>Non-communicé</b>
<b>UTILISATION</b>	
Emission de COV (mg/h)	<b>Non-communicé</b>
Limitation des champs électromagnétiques créés par le produit	<b>Non-communicé</b>
<b>DURÉE DE VIE EN PARC</b>	
Durée de garantie (année)	<b>3</b>
Disponibilité des pièces dans le temps (année)	<b>0</b>
<b>FIN DE VIE</b>	
Exclu des substances au-delà des exigences réglementaires	<b>Non</b>
Identification des plastiques	<b>Oui</b>
Contient des substances REACH	<b>Oui</b>
Contient du PVC dans les parties extérieures du produit	<b>Non-communicé</b>
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les plastiques	<b>Non-communicé</b>
Contient du mercure dans les sources de lumières dans l'électronique	<b>Non-communicé</b>
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les circuits imprimés et dans l'électronique	<b>Non-communicé</b>
Contient du PVC dans l'électronique	<b>Non-communicé</b>
Présence de revêtement de surface pour les parties plastiques du boîtier/capots	<b>Non</b>
Communication du pourcentage de recyclabilité, selon le calcul IEC/TR 62635:2012	<b>Non</b>
Extension ou échange de la mémoire possible	<b>Oui</b>
Possibilité d'échange ou d'extension de la capacité de stockage	<b>Oui</b>
Parties et étiquettes facilement	<b>Oui</b>

séparables

Pièces plastiques monomatériaux ou facilement séparables **Oui**

Pièces plastiques sans incrustation métallique ou faciles à extraire avec les outils couramment disponibles **Oui**

## CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



**C-**

**27.9 W**

Consommation en marche (W)

**1.7 W**

Consommation en veille (W)

Dispositif d'économie d'énergie **Oui**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Nom de la carte graphique **GPU NVIDIA**

Taille du disque dur **500**

Type de disque dur **SATA**

Type de RAM **DDR3**

Type de processeur **Intel Core i5**

Cadence du processeur (GHz) **2,3**

Dimensions HxLxP (mm) **429 x 608 x 187**

Taille écran (pouce) **24**

Ecran tactile **Oui**